

合肥新汇成微电子股份有限公司

关于控股子公司晶瑞旺增资郑隆芯创的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- **增资标的名称：**上海郑隆芯创微电子有限公司（以下简称“郑隆芯创”）。
- **增资金额及资金来源：**合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“汇成股份”）控股子公司合肥晶瑞旺电子有限公司（以下简称“晶瑞旺”）拟以其自有资金或自筹资金向其全资子公司郑隆芯创增资人民币68,000.00万元。

- **交易实施尚需履行的审批及其他相关程序**

本次增资事项已于2026年7月13日获得公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。

- **其他需要提醒投资者重点关注的风险事项**

本次增资尚需办理资金交割、工商变更登记等手续。

本次增资对象为公司控股子公司晶瑞旺的全资子公司郑隆芯创，整体风险可控，但仍受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，郑隆芯创未来经营状况和盈利情况存在不确定性的风险。

公司将加强对子公司的运营管控，确保其合规、稳健、高效经营，提高资金使用效率，加强风险管控，力争取得良好的投资回报。敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次增资概述

（一）本次增资概况

为保障郑隆芯创“HITS 先进封装研发产业化项目”资金需求，推动公司 HITS 先进封装工艺平台和研发总部建设进程，公司控股子公司合肥晶瑞旺电子有限公司拟以其自有资金或自筹资金向其全资子公司郑隆芯创增资人民币 68,000.00 万元。

（二）本次增资履行的审议程序

2026 年 7 月 13 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于控股子公司晶瑞旺增资郑隆芯创的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，本次增资事项在公司董事会权限范围内，无需提交股东会审议。

（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项

本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资主体基本情况

法人/组织全称	合肥晶瑞旺电子有限公司
统一社会信用代码	☒ 91340100MAKGCDHD3H ☐ 不适用
法定代表人	郑瑞俊
成立日期	2026/07/03
注册资本	人民币 70,000.00 万元整
注册地址	安徽省合肥市新站区站北社区铜陵北路与西淝河路交叉口科创大厦 A 栋 13 层 13022 室
控股股东	合肥新汇成微电子股份有限公司
主营业务	集成电路封装测试
所属行业	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业
是否失信被执行人	否
主要财务数据	因成立时间较短，暂无最近一年又一期财务数据

三、增资标的基本情况

（一）增资标的概况

公司拟充分利用核心工艺技术积累，协同具备丰富产业经验的技术团队，共同拓展 HITS 先进封装工艺平台，以满足客户更高集成度、更高性能及更高可靠性的封装及测试服务需求，把握人工智能（AI）及高性能计算（HPC）领域的市场增长机遇。为此，公司与关联方共同出资设立合资公司晶瑞旺，合资公司晶瑞旺设立后零元收购上海郑隆芯创微电子有限公司 100%股权。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资设立合资公司及股权收购暨关联交易的公告》（公告编号：2026-054）。

近日，合资公司晶瑞旺已完成设立并收购郑隆芯创 100%股权，郑隆芯创将作为 HITS 先进封装研发总部，承担技术工艺研发及业务导入的重要功能。

郑隆芯创计划在上海市嘉定区南翔镇投资建设“HITS 先进封装研发产业化项目”，项目投资总额预计不低于人民币 75 亿元（最终以项目建设实际投资金额为准）。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于郑隆芯创拟对外投资的公告》（公告编号：2026-067）。

（二）增资标的的信息

1、增资标的基本情况

投资类型	☒ 增资现有公司（ ☒ 同比例 ☐ 非同比例）
标的公司类型（增资前）	控股子公司（郑隆芯创为公司控股子公司晶瑞旺之全资子公司）
法人/组织全称	上海郑隆芯创微电子有限公司
统一社会信用代码	☒ 91310000MAKCJCUK52 ☐ 不适用
法定代表人	吴正隆
成立日期	2026/05/18
注册资本	人民币 2,000.00 万元整
实缴资本	0
注册地址	上海市嘉定区蕴北公路 2021 弄 3 号 1 层 A 区 102 室

控股股东	合肥晶瑞旺电子有限公司
主营业务	集成电路封装测试
所属行业	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业

2、增资标的最近一年又一期财务数据

郑隆芯创成立时间较短，尚未实缴出资和开展实际运营，暂无最近一年又一期财务数据。

3、增资前后股权结构

单位：万元

股东名称	增资前		增资后	
	出资金额	占比(%)	出资金额	占比(%)
合肥晶瑞旺电子有限公司 (汇成股份控股子公司)	2,000.00	100.00	70,000.00	100.00

(三) 出资方式及相关情况

本次增资以现金方式出资，资金来源为晶瑞旺自有资金或自筹资金，不涉及汇成股份发行 A 股普通股股票或者可转换公司债券等形式募集资金。

四、本次增资对上市公司的影响

本次增资决策根据公司整体投资规划的具体需要作出，不涉及上市公司发行 A 股普通股股票或者可转换公司债券等形式募集资金，增资完成后将增强郑隆芯创资本实力，推动 HITS 先进封装工艺平台和研发总部建设进程，提升公司未来盈利能力与资产回报率。本次增资不会对公司的正常生产及经营产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、本次增资的风险提示

本次增资尚需办理资金交割、工商变更登记等手续。

本次增资对象为公司控股子公司晶瑞旺的全资子公司郑隆芯创，整体风险可控，但仍受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，郑隆芯创未来经营状况和盈利情况存在不确定性的风险。

公司将加强对子公司的运营管控，确保其合规、稳健、高效经营，提高资金使用效率，加强风险管控，力争取得良好的投资回报。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

合肥新汇成微电子股份有限公司董事会

2026年7月14日